

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012年1月5日(05.01.2012)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/002134 A1

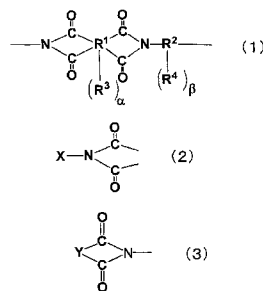
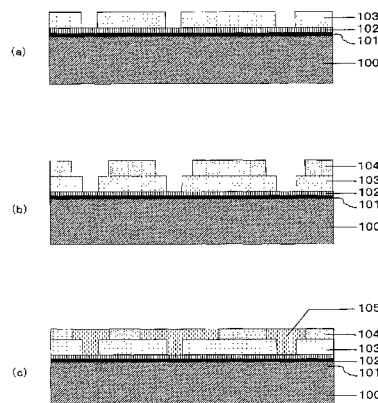
- (51) 国際特許分類:
G03F 7/023 (2006.01) C09J 179/08 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01) G03F 7/004 (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/063339
- (22) 国際出願日: 2011年6月10日(10.06.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-151596 2010年7月2日(02.07.2010) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社(TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 仁王宏之(NIWA, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告(条約第21条(3))

[続葉有]

(54) Title: PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION FILM, AND SEMI-CONDUCTOR DEVICE USING THE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION OR THE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION FILM

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物、感光性樹脂組成物フィルムおよびこれらを用いた半導体装置

【図1】



(57) Abstract: Disclosed are a photosensitive resin composition and a photosensitive resin composition film, each of which has small stress after curing and exhibits excellent adhesion after thermal compression bonding. Specifically disclosed is a photosensitive resin composition which is characterized by containing: (a) an alkali-soluble polyimide which has a structural unit represented by general formula (1), while having a structure represented by general formula (2) and/or (3) at at least one end of the main chain; (b) a compound which has two or more epoxy groups and/or oxetanyl groups in each molecule; and (c) a quinonediazide compound. The photosensitive resin composition is also characterized in that: less than 10 parts by weight of an acrylic resin is contained per 100 parts by weight of the polyimide (a); and the content of the compound (b) is not less than 20 parts by weight per 100 parts by weight of the polyimide (a).

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2012/002134 A1



硬化後の応力が小さく、熱圧着後の接着性に優れる感光性樹脂組成物および感光性樹脂組成物フィルムを提供する。(a) 下記一般式(1)で表される構造単位を有し、かつ主鎖末端の少なくとも一方に一般式(2)および/または(3)で表される構造を有するアルカリ可溶性ポリイミド(b)分子内にエポキシ基および/またはオキセタニル基を2つ以上有する化合物、(c) キノンジアジド化合物を含有し、(a)のポリイミド100重量部に対するアクリル樹脂の含有量が10重量部未満であり、(b)の化合物の含有量が(a)のポリイミド100重量部に対して20重量部以上であることを特徴とする感光性樹脂組成物。